

供媒體即時發佈

投資者關係：

Ed Lockwood

投資者關係資深總監

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒體關係：

Meggan Powers

企業宣傳資深總監

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

### **KLA-Tencor 宣佈推出新的 CIRCL™ Suite**

*採用高效積體電路製程監控 DirectedSampling™*

*技術的全表面、多功能晶圓缺陷與測量組合工具*

【加州 MILPITAS 2012 年 4 月 23 日訊】 [KLA-Tencor Corporation](http://www.kla-tencor.com) (NASDAQ: KLAC) 今天宣佈，為尖端晶片製造商推出一套新的高產能缺陷檢測／測量／複查系統 — CIRCL™ Suite。這套新的組合工具專為微影作業、出貨品質控制 (OQC) 及其他製程模組而設計，不僅能監控晶圓的正面、背面及邊緣缺陷，同時還能測量晶圓邊緣輪廓、晶邊清除同心性和巨觀疊對誤差。資料收集採用一種創新方法 DirectedSampling™ 控制，可以根據需要，利用一次測量的結果觸發組合工具內其他類型的測量。

KLA-Tencor SWIFT 部門總經理 Oreste Donzella 表示：「實現高端記憶體與邏輯裝置的良率及效能目標需要對爆炸性數量的製程參數進行非常嚴密的監控。新的 CIRCL Suite 同時兼顧所有晶圓表面，以極具成本效率的方式進行最恰當的組合測量。我們認為，CIRCL 的優勢在於能夠同時運用多種缺陷檢查、測量與複查技術，協助客戶在發生偏移時找出並解決偏移問題。」

CIRCL Suite 結合了經業界證明的新世代 LDS 晶圓正面巨觀缺陷檢測模組；一個基於 KLA-Tencor 旗艦 VisEdge™ 技術的新型模組化邊緣檢測、晶邊輪廓描繪與測量模組；一個專用晶圓背面檢測模組；以及一個靈活的光學缺陷複查與分類模組。這套 CIRCL 組合工具能夠為滿足某個晶圓廠的特定製程控制需要進行模組化結構調整。它的模組化結構減少了佇列時間和晶圓廠空間，並在設計上允許根據應用需要進行模組化升級以符合經濟效益，無論是現在還是在平台的壽命週期內，都能達到良好的投資回報績效。

CIRCL Suite 的廣泛功能讓晶圓廠工程師能夠解決形形色色的良率和效能問題，包括：

- 對晶圓正面多種類型的巨觀缺陷進行檢測與分類，從微粒污染到跨越多個晶粒的失焦缺陷，到全晶圓缺陷，例如光阻缺失；
  - 較低百分比的非關鍵缺陷，讓工程師能迅速且精準地處理生產材料；
  - 光罩 ID 檢查，以驗證使用正確的光罩進行曝光生產；
  - 巨觀疊對誤差監控，以檢查層與層相對的圖案對準；
  - 檢測晶圓背面的缺陷，這些地方的微粒與刮傷有可能影響在晶圓正面微影曝光的圖案線寬；
  - 晶邊缺陷的檢測與分類，這些缺陷會遷移到晶粒區，導致良率降低；
  - 晶邊去除 (EBR) 測量，用於監控薄膜的同心性和邊緣完整性，以避免可能發生的剝落缺陷；
  - 校準自動邊緣輪廓測量，以識別在浸沒微影期間會導致水珠洩露或薄膜分層的偏移；
- 以及
- 晶圓正面和邊緣缺陷的自動高解析度光學缺陷複查與分類，協助工程師迅速找到缺陷來源。

這些構成 CIRCL Suite 的模組能夠與其他 CIRCL 工具中的類似模組搭配使用，以促進正在進行工作的靈活選擇，並提升基線穩定性。為了保持高效能和高產能，CIRCL 組合工具由 [KLA-Tencor 的全球綜合服務網路](#) 提供支援。

CIRCL 模組已經送往領先的晶圓代工廠、邏輯電路與記憶體晶片製造商，用於先進的開發和生產線。關於 KLA-Tencor 的 CIRCL 組合工具的更多資訊，請參觀產品網頁：<http://www.kla-tencor.com/front-end-defect-inspection/CIRCL.html>。

#### **關於 KLA-Tencor：**

KLA-Tencor Corporation 是製程控制與良率管理解決方案的領先提供商，與全球客戶合作開發先進的檢測與度量技術，為半導體、資料儲存、LED、光電及其他相關奈米電子產業提供服務。公司擁有廣泛的業界標準產品系列及世界一流的工程師與科學家團隊，三十五年來一直為客戶努力打造優秀的解決方案。KLA-Tencor 的總部設在美國加利福尼亞州米爾皮塔斯 (Milpitas)，並在全球各地設有專屬的客戶營運與服務中心。如需更多資訊，請參觀網站 [www.kla-tencor.com](http://www.kla-tencor.com) (KLAC-F)。

#### **前瞻性聲明：**

本新聞稿中除歷史事實以外的聲明，例如關於 CIRCL 的預期效能，半導體產業的趨勢及其帶來的預期挑戰，KLA-Tencor 的客戶對 Pivot 平台的預期使用，CIRCL 平台提供新功能的預期可擴展性，以及 CIRCL 工具使用者可以實現的預期成本、營運與其他受益等陳述，均為前瞻性聲明，並受到《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 規定的「安全港」(Safe Harbor) 條款的制約。這些前瞻性聲明基於當前資訊及預期，且包含諸多風險與不確定性。由於各種因素，包括延遲採用新技術（無論是由於成本或效能問題抑或其他問題），其他公司推出競爭性產品，或影響 KLA-Tencor 產品的實現、效能或使用的意外技術挑戰或限制，因此實際結果可能與此類聲明中的預計結果實質不同。

###